

第2世代Xeon® スケーラブル・プロセッサーを2基搭載 ハイエンドGPU×1枚搭載可能

画像処理・マシンビジョン向け ラックマウント型PC
IPC-C621DPL-R4



- 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載
- デュアルCPU搭載時、最大40コア(80スレッド)搭載
※Gold 6230プロセッサー
- インテル® C621 チップセット装備
- 最大2TBメモリー (DDR4)搭載可能
- すべてのPCI ExpressはCPU側と直結
- LAN×2基、IPMI×1基を装備
- ハイエンドGPUボードが1枚搭載可能
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載



☑ 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを2基搭載

IPC-C621DPL-R4には、14nm世代の最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を2CPU搭載しています。上位モデルのXeon® Gold 6230を選択すると最大40コア80スレッド(2CPU搭載時)になります。

☑ 画像処理・マシンビジョン向け拡張ボードが増設できる優れた拡張性

IPC-C621DPL-R4に装備しているすべてのPCI Expressは、CPU側とダイレクトに接続しています。拡張ボードはPCH側を経由せず直接CPUと高速通信ができます。ハイエンドGPUやフレームグラバーボードなどを搭載しても処理速度の低下を招くことはありません。

製品仕様

モデル	IPC-C621DPL-R4	
プロセッサ	種類	第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ 【長期供給性 有】 Gold 6230 (20コア40スレッド、2.10GHz、ターボ・ブースト時3.90GHz、TDP125W) Gold 6226 (12コア24スレッド、2.70GHz、ターボ・ブースト時3.70GHz、TDP125W) Gold 5215 (10コア20スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時3.40GHz、TDP85W) Silver 4215 (8コア16スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時3.50GHz、TDP85W) 【長期供給性 無】 Gold 6234 (8コア16スレッド、3.30GHz、ターボ・ブースト時4.00GHz、TDP130W) Gold 6128 (6コア12スレッド、3.40GHz、ターボ・ブースト時3.70GHz、TDP115W) Gold 5222 (4コア8スレッド、3.80GHz、ターボ・ブースト時3.90GHz、TDP105W)
	搭載数	2
チップセット	インテル® C621 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz
	容量	標準32GB (8GB×4) ※最大2TB
	スロット数	8
ストレージ	5インチベイ	3(空き2) ※標準:データ用1TB HDD×1 (3.5インチ→5インチ変換マウントを使用)
	3.5インチベイ	内部1(空き0) ※標準:システム用480GB SSD×1 (2.5インチ変換マウントを使用。最大2台まで搭載可能)
	SATAコネクタ数	10 (空き8) (SATA 3.0) ※標準:ストレージ ×2で使用
グラフィックス	Aspeed AST2500 BMC	
I/O	VGA	1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB2.0)
	LAN	2 (GbE)
	IPMI	1
拡張スロット	SLOT7 : None SLOT6 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) ※メモリスロットと位置が重なるため、カード長に制限あり SLOT5 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、16シグナル、CPU1側) SLOT4 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) SLOT3 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、x16シグナル、CPU2側) SLOT2 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) SLOT1 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x4シグナル、CPU1側)	
外形寸法	4Uラックマウント W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く)	
重量	約18.0kg	
電源	ニプロン電源 822W (連続最大容量)/1000W (ピーク容量)	
利用環境	入力電圧	AC90V~240V
	温度	10℃~35℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃~55℃
	湿度	20%~80% RH (結露なきこと)

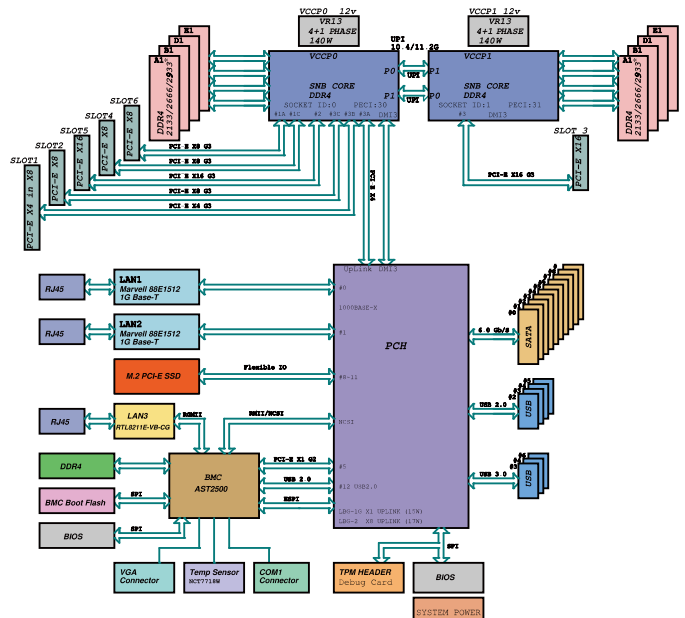
拡張スロット



I/Oポート



ブロック図



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間:9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL:03-5446-5535 mail:cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト:https://embe.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viviv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2019年11月現在の内容です。